

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه شاهد

دانشکده علوم پایه - گروه فیزیک

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته فیزیک بنیادی

بررسی خواص لایه های نازک نیترید مس تهیه شده بر روی زیرلایه های سیلیکون و کوارتز در دماهای متفاوت زیرلایه توسط سیستم کندوپاش مغناطیسی واکنشی DC

هادی شاعری

اساتید راهنما:

دکتر جهانگیر پیام آرا

دکتر محمود قرآن نویس

بهمن ماه ۱۳۹۱

شماره :		
تاریخ:	اظهار نامه دانشجو	

اینجانب هادی شاعری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک بنیادی دانشکده علوم پایه دانشگاه شاهد، گواهی می دهم که پایان نامه تدوین شده حاضر با عنوان «بررسی خواص لایه های نازک نیترید مس تهیه شده بر روی زیرلایه های سیلیکون و کوارتز در دماهای متفاوت زیرلایه توسط سیستم کندوپاش مغناطیسی واکنشی DC » به راهنمایی استادی محترم، جناب آقای دکتر جهانگیر پیام آرا و دکتر محمود قرآن نویس توسط شخص اینجانب انجام و صحت و اصالت مطالب تدوین شده در آن، مورد تایید است و چنان چه هر زمان، دانشگاه کسب اطلاع کند که گزارش پایان نامه صحت و اصالت لازم را نداشته، دانشگاه حق دارد، مدرک تحصیلی اینجانب را مسترد و ابطال نماید هم چنین اعلام می دارم در صورت بهره گیری از منابع مختلف شامل گزارش های تحقیقاتی، رساله، پایان نامه، کتاب، مقالات تخصصی وغیره، به منبع مورد استفاده و پدید آورنده آن به طور دقیق ارجاع داده شده و نیز مطالب مندرج در پایان نامه حاضر تاکنون برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی توسط اینجانب و یا سایر افراد به هیچ کجا ارایه نشده است. در تدوین متن حاضر، چار چوب(فرمت) مصوب تدوین گزارش های پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد به طور کامل مراعات شده و نهایتاً این که کلیه حقوق مادی ناشی از گزارش پایان نامه حاضر، متعلق به دانشگاه شاهد می باشد.

نام و نام خانوادگی دانشجو(هادی شاعری)

امضاء دانشجو:

تاریخ:

تقدیر و تشکر:

پس از شکر و سپاس از خالق هستی

بر خود لازم می دانم از زحمات ارزشمند استاد راهنمای این پژوهه، جناب آقای دکتر جهانگیر پیام آرا و جناب آقای دکتر محمود قرآن نویس که اینجانب را در اجرای تمامی مراحل یاری نموده اند، ارج بگذارم و تشکر نمایم.

از دکتر رضا پورصالحی، استاد بزرگوار دانشگاه شاهد و دانشکده نانومواد دانشگاه تربیت مدرس و دکتر حنطه زاده، استاد گرانقدر دانشکده فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، که مرا در اکثر زمینه های علمی و کاربردی این پژوهه، تحلیل آنالیز نمونه ها، و در اختیار قرار دادن مقالات مربوطه و بویژه راهنمایی جهت تعمیر دستگاه کندوپاش در حین کار، یاری نموده اند، کمال قدردانی و تشکر بعمل می آورم.

همچنین بر خود لازم می دانم از سرکار خانم مرتضوی، مسئول آزمایشگاه تفنگ الکترونی و سیستم کندوپاش ، خانم میلانی، مسئول آزمایشگاه اسپیکتروفوتومتری و AFM ، خانم فضل الهی، مسئول آزمایشگاه XRD دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، مسئولین آزمایشگاه ضخامت سنجی و مقاومت سنجی دانشگاه تهران و آقای طباطبایی ، مسئول آزمایشگاه AFM دانشگاه شاهد، صمیمانه سپاسگذاری نمایم.

فهرست:

صفحه

موضوع:

فهرست شکلها و جداول

چکیده

۱.....	فصل اول-فیزیک لایه های نازک
۱.....	۱-۱ مقدمه
۲.....	۲-۱ کاربردهای لایه های نازک
۴.....	۳-۱ روشهای لایه نشانی
۴.....	۳-۱-۱ روشهای شیمیایی و الکتروشیمیایی
۵.....	۳-۱-۲ روشهای فیزیکی
۶.....	۴-۱ خواص ویژه لایه های رونشانی شده به روش کندوپاش کاتدی
۷.....	۵-۱ ساز و کار تشکیل لایه های نازک
۷.....	۵-۱-۱ مراحل تشکیل لایه های نازک
۸.....	۵-۱-۲ بررسی دمای زیرلایه بر فرایند هسته بندی
۱۳.....	۵-۱-۳ عوامل موثر بر ساختار نهایی لایه
۱۴.....	۶-۱ ساختار بلور نگاشتی لایه های نازک
۱۷.....	۷-۱ لایه های برآراستی

۱۹.....	۱-۸ خواص لایه های نازک.....
۱۹.....	۱-۸-۱ خواص مکانیکی.....
۲۱.....	۱-۸-۲ خواص الکتریکی و مغناطیسی لایه های نازک
۲۳.....	۱-۹ خواص فیزیکی لایه های نازک نیمرسانا.....
۲۵.....	فصل دوم - مقدمه ای بر شناخت نیمه رساناهای ساختار نیترید مس.....
۲۵.....	۱-۲ مقدمه.....
۲۶.....	۲-۲ ساختار بلوری نیمه رساناهای.....
۲۶.....	۲-۳ ساختار نواری
۲۹.....	۴-۲ فرآیند جذب اساسی
۳۱.....	۵-۲ خواص الکتریکی و اپتیکی لایه های رسانا و نیمه رسانا.....
۳۶.....	۱-۵-۲ خواص نوری فونونها.....
۳۷.....	۲-۵-۲ نیمرساناهای با گاف انرژی مستقیم و غیر مستقیم.....
۴۰.....	۳-۵-۲ جذب در نیمه رساناهای گاف مستقیم و غیرمستقیم.....
۴۲.....	۶-۲ خواص نیترید مس.....
۴۴.....	فصل سوم - آشنایی با وسایل اندازه گیری و آنالیز لایه های نازک.....
۴۴.....	۱-۳ مقدمه.....

۴۵.....	۳ ۲ پلاسما
۴۶.....	۳-۲-۱ اکاربردهای پلاسما
۴۶.....	۳-۲-۲ حرکتهای تک ذره پلاسما
۴۷.....	۳-۲-۳ حرکت الکترون و یون در حضور میدان الکتریکی و مغناطیسی متناهی
۴۹.....	۳-۳ فرایند کندوپاش
۴۹.....	۳-۳-۱ بر همکنش یون با سطح
۴۹.....	۳-۳-۲ گسیل ذرات
۴۹.....	۳-۳-۳ یونهای ثانویه
۵۰.....	۳-۳-۴ ذرات بازتابشی
۵۰.....	۳-۳-۵ فوتونها و اشعه X
۵۰.....	۳-۳-۶ کاشت یون
۵۱.....	۳-۳-۷ افت دیواره
۵۱.....	۳-۳-۸ اثرات انواع گاز و فشار آن
۵۲.....	۳-۳-۹ جذب و ترکیب گاز
۵۲.....	۳-۳-۱۰ حاصل کندوپاش
۵۴.....	۳-۴ دستگاه کندوپاش کاتدی مغناطیسی
۵۹.....	۳-۵ دستگاه XRD
۵۹.....	۳-۵-۱ ویژگی پرتو X
۵۹.....	۳-۵-۲ تولید پرتو X
۶۱.....	۳-۵-۳ قانون برآگ

۶۴	۴-۵ کاربردهای پراش پرتو ایکس
۶۵	۳-۵ اندازه دانه های بلوری
۶۷	۳-۶ میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)
۶۸	۳-۶-۱ نحوه عملکرد AFM
۷۰	۳-۶-۲ مدهای عملکردی AFM
۷۱	۳-۶-۲-۱ مدهای تماسی
۷۲	۳-۶-۲-۲ مد نیرو ثابت
۷۳	۳-۶-۲-۳ مد ارتفاع ثابت
۷۴	۳-۶-۲-۴ مد شبه تماسی
۷۵	۳-۶-۲-۵ مد خطای تماسی و شبه تماسی
۷۶	۳-۶-۲-۶ مد تصویربرداری از اختلاف فاز
۷۷	۳-۷ اسپکتروفوتومتر
۷۸	۳-۷-۱ ساختمان دستگاه
۷۸	۳-۷-۲ مشخصات دستگاه طیف سنج نوری مورد استفاده در این پژوهش
۷۹	۳-۷-۳ نحوه کار با دستگاه
۸۰	۳-۷-۴ مزایای دستگاه
۸۱	۳-۸-۱ اندازه گیری مقاومت الکتریکی با پربوی چهار سوزنی:
۸۲	۳-۸-۲ نکات مهم کار با دستگاه مقاومت سنج پربوی چهار سوزنی:
۸۳	۳-۹-۱ ضخامت سنج (profilometer)
۸۵	فصل چهارم- بررسی شرایط لایه نشانی نیترید مس
۸۵	۴-۱ مقدمه

۴-۲ رشد لایه نازک نیترید مس بر زیر لایه های گوناگون.....	۸۶
۴-۳ رشد لایه های نیترید مس در یک دمای خاص و سپس انجام عملیات Annealing و مقایسه با حالت اول.....	۸۸
۴-۴ مقایسه لایه های نازک نیترید مس تهیه شده با دماهای متفاوت زیرلایه.....	۹۲
۴-۵ رشد لایه های نیترید مس با زمانهای متفاوت.....	۹۶
۴-۶ تغییرات خصوصیات نیترید مس با وارد کردن یک اتم فلزی به درون شبکه بلوری آن.....	۹۹
۴-۷ تأثیر توان دستگاه اسپاترینگ بر رشد لایه های نیترید مس.....	۱۱۴
۴-۸ تأثیر شار و فشار جزیی نیتروژن بر ساختار و رشد لایه های نیترید مس.....	۱۱۸
۴-۹ استفاده از ترکیب گازهای نیتروژن و هیدروژن(به جای گاز ختنی) جهت رشد لایه نیترید مس	۱۲۲
۴-۱۰ مقایسه دستگاههای مختلف لایه نشانی.....	۱۲۷
فصل پنجم - شرح و تحلیل نتایج آزمایش.....	۱۲۹
۴-۱۱ شرح آزمایش	۱۲۹
۴-۱۲ نکات و اقدامات اولیه جهت تهیه نمونه ها.....	۱۲۹
۴-۱۳ مزیتهای کوارتز نسبت به شیشه و سیلیکون.....	۱۳۱
۴-۱۴ تمیز کردن و آماده سازی دستگاه کندوپاش	۱۳۳
۴-۱۵ تمیز کردن ورقه مسی	۱۳۳
۴-۱۶ تمیز کردن زیرلایه ها	۱۳۴

۱۳۵.....	۶-۱-۵ راه اندازی دستگاه و انجام آزمایش.
۱۳۸.....	۲-۵ معرفی قسمتهای مختلف سیستم کندوپاش
۱۴۱.....	۳-۵ نتایج و تحلیل آنها
۱۴۱.....	۳-۱-۵ تحلیل طرح پراش اشعه X (XRD) X
۱۵۱.....	۲-۳-۵ ثابت شبکه و اندازه دانه های بلوری نمونه ها
۱۵۳.....	۳-۳-۵ نتایج و تحلیل اندازه گیری مقاومت الکتریکی لایه ها
۱۵۴.....	۳-۴-۵ نتایج و تحلیل آنالیز AFM
۱۵۹.....	۳-۵-۵ ضخامت سنجی
۱۶۱.....	۶-۳-۵ اسپکتروفوتومتری
۱۶۱.....	۱-۶-۳-۵ طیف عبور و بازتاب
۱۶۴.....	۲-۶-۳-۵ نمودار جذب لایه ها
۱۶۶.....	۳-۶-۳-۵ گاف انرژی
۱۷۱.....	۴-۶-۳-۵ ضریب خاموشی ، ضریب شکست و ضریب دی الکتریک
۱۷۶.....	۴- خلاصه نتایج

پیشنهادات

منابع

چکیده انگلیسی

فهرست شکلها:

۱-۱: مراحل مختلف رشد لایه ای از جنس آنتیموان	۷
۱-۲: وضعیت نور تابشی به یک بلور واقعی و یک یلور ایده آل	۱۴
۱-۳: مهمترین صفحه ها در سیستم مکعبی	۱۶
۲-۱: شماتیک شکاف انرژی بین نوار رسانش و نوار ظرفیت در فلزات ، نیمه رساناها و نارساناها	۲۷
۲-۲: گذار الکترونها در نیمه رساناها	۲۸
۳-۱: ساده ترین ساختار نواری در یک نیمه رسانا	۲۹
۳-۲: گاف انرژی مستقیم و غیر مستقیم	۳۹
۴-۱: شماتیک یک سیستم کندوپاش کاتدی ساده	۴۳
۴-۲: ساختار بلوری نیترید مس (Cu_3N)	۵۵
۴-۳: شماتیک عملکرد یک سیستم کندوپاش معناطیسی	۵۸
۴-۴: شماتیک مدار داخلی یک نمونه دستگاه تولید پرتوهای ایکس.	۶۱
۴-۵: بازتاب پرتوهای ایکس از یک بلور	۶۱
۴-۶: بردار پراکندگی s	۶۲
۴-۷: بردار پراکندگی مساوی بردار شبکه وارون است	۶۴
۴-۸: نمودار فرضی یک پیک از آنالیز XRD جهت شناخت FWHM	۶۵
۴-۹: منحنی تابعیت نیروی وارد بر سوزن از فاصله سوزن از سطح	۶۸

۱۰-۳ : شماتیک تصویربرداری از سطح در مد غیرتماسی.....	۷۰
۱۱-۳ : شماتیک عملکرد AFM در مد نیرو ثابت.....	۷۲
۱۲-۳ : شماتیک عملکرد AFM در مد ارتفاع ثابت.....	۷۳
۱۳-۳ : مد شبیه تماسی ارتعاشی (در یک خط روش)	۷۴
۱۴-۳ : شماتیک عملکرد AFM در مد خطای تماسی و شبیه تماسی.....	۷۶
۱۵-۳ : شماتیک عملکرد AFM در مد تصویربرداری از اختلاف فاز.....	۷۶
۱۶-۳ : نمای کلی از عملکرد دستگاه اسپکتروفتوومتر.....	۷۷
۱۷-۳ : شماتیک دستگاه 4 point probe .	۸۱
۱۸-۳ : نمای دستگاه DEKTAK3	۸۴
۱-۴: طیف پراش XRD (a) پودر نیترید مس (b) روی زیرلایه Al ₂ O ₃ (c) روی زیرلایه Pt/MgO	۸۸
۲-۴ : چگالی نیتروژن و مس در کل لایه در دماهای بازپخت متفاوت.....	۸۹
۳-۴ : نمودار XRD نمونه ها.....	۹۰
۴-۴ : شماتیک نمونه ها در (a) پس از تهیه لایه (b) پس از بازپخت در دمای 100°C (c) پس از بازپخت با دمای 300°C	۹۱
۵-۴ : طیف XRD لایه ها قبل و پس از بازپخت.....	۹۲
۶-۴ : نمودار های طرح پراش پرتو X لایه ها.....	۹۳
۷-۴ : وابستگی مقاومت ویژه الکتریکی لایه ها به دمای زیرلایه.....	۹۴

- ۸-۴ : طیف XRD لایه های نشانده شده بر زیرلایه سیلیکون در دماهای متفاوت زیرلایه در فشار جزیی گاز نیتروژن 3.75 mTorr ۹۵
- ۹-۴ : قسمتهای حقیقی و موهمی تابع دی الکتریک لایه $\text{Cu}_3\text{N}/\text{Si}$. خطوط کمرنگ قسمتهای حقیقی و موهمی تخمین زده شده با یک مدل multilayer می باشد. ۹۶
- ۱۰-۴ : نتایج آنالیز XRD لایه ها ۹۸
- ۱۱-۴ : تصاویر سه بعدی AFM لایه ها ۹۸
- ۱۲-۴ : ساختار a) نیترید مس خالص b) dope کردن در یک سلول واحد c) اضافه کردن یک اتم در یک سلول بزرگ d) سلولی بزرگ شامل جفت اتمهای یک فلز انتقالی 3d ۹۹
- ۱۳-۴ : طیف XRD لایه های نهشته در توانهای مختلف دستگاه در فشار گاز نیتروژن a) 0.7 Pa و b) 0.9 Pa ۱۰۴
- ۱۴-۴ : تصویر TEM از یک نمونه از لایه های نیترید مس در فشار کاری 0.9 Pa و با توان 70 W ۱۰۴
- ۱۵-۴ : وابستگی مقاومت الکتریکی نیترید مس به دما a) برای بلورهای تقریباً استوکیومتری نیترید مس b) برای نمونه غنی از مس با 78.8% مس ۱۰۵
- ۱۶-۴ : تأثیر مقدار مس در ترکیب بر مقاومت الکتریکی ۱۰۶
- ۱۷-۴ : تصویر SEM از یک نمونه لایه نیترید مس به ضخامت تقریبی $0.6\mu\text{m}$ ۱۰۶
- ۱۸-۴ : ساختار پنج ضلعی (و پنج پر) نیترید مس گرفته شده توسط دستگاه TEM ۱۰۷
- ۱۹-۴ : طیف XRD ترکیب Cu_3NPd_x با مقادیر x متفاوت ۱۰۸

- ۲۰-۴ : تأثیر دما بر مقاومت الکتریکی ترکیب Cu_3NPd_x با مقادیر x برابر ۰.۰۴۸(b) و ۰.۰(a) با مقادیر ۰.۱۷۵(e) و ۰.۰۷۱(d) (c) در سه دمای ۱۰۹.....۰.۳۴۹(f) ۰.۲۳۸(e) ۰.۱۷۵(d) ۰.۰۷۱(c) در سه دمای ۸.۲% (c) ۴.۶۲% (b) ۰% (a: In_xIn_yN با مقادیر x و y)
- ۲۱-۴ : طیف XRD ساختار ۸.۲% (c) ۴.۶۲% (b) ۰% (a: In_xIn_yN با مقادیر x و y)
- ۲۲-۴: بازپخت نمونه ۲٪ در سه دمای ۱۱۰.....۴۷.۹۸% (h) ۳۵.۷% (g) ۳۰.۴۳% (f) ۲۳.۶۴% (e) ۱۰.۷۹% (d) ۳۶۰⁰C(c) ۳۳۰⁰C(b) ۱۰۰⁰C(a)
- ۲۳-۴ : طیف XRD ساختار Zn₃NZnx با نسبتهای متفاوت از ۱۱۱.....Zn
- ۲۴-۴ : مقاومت الکتریکی Zn₃NZnx در دمای اتاق.....نسبت به مقادیر Zn در دمای اتاق ۱۱۲.....
- ۲۵-۴ : نمودار XRD مربوط به لایه های نیترید مس با اضافه کردن اکسیژن در حین لایه نشانی با نسبت اکسیژن ۰.۰% (a) ۰.۵% (b) ۱.۰% (c) ۱.۵% (d) ۲.۰% (e) ۲.۵% (f) درصد اکسیژن در ۱۱۳.....
- ۲۶-۴ : نمودار XRD دو نمونه لایه نازک اکسی نیترید مس با مقدار ۱ و ۱/۵ درصد اکسیژن در دمای بازپخت ۳۰۰⁰C (c) ۳۳۰⁰C (d) ۳۶۰⁰C (b) بدون بازپخت (a) فقط برای نمونه ۱.۵% (۱۱۴....)
- ۲۷-۴ : نمودار پراش پرتو X (XRD) لایه های تهیه شده در توانهای مختلف دستگاه کندوپاش ۱۱۶.....
- ۲۸-۴ : طیف عبوری لایه تهیه شده با توان ۱۲۰ وات b) چگونگی بدست آوردن گاف انرژی همین لایه ۱۱۷.....
- ۲۹-۴ : گاف انرژی لایه ها در توانهای مختلف دستگاه کندوپاش در حین لایه نشانی ۱۱۷.....
- ۳۰-۴ : طرح پراش اشعه X لایه های نیترید مس تهیه شده با شارهای متفاوت گاز نیتروژن ۱۱۹.....
- ۳۱-۴ : تغییر اندازه ثابت شبکه با میزان شار گاز نیتروژن ۱۲۰.....
- ۳۲-۴ : طرح پراش اشعه X لایه های نیترید مس تهیه شده با فشار گاز نیتروژن متفاوت ۱۲۱.....

۴-۳۳ : نمودار XRD (a) دو نمونه با شار هیدروژن صفر (b) ۵ نمونه با شارهای مختلف.....	۱۲۳
۴-۳۴ : با افزایش شار هیدروژن مقاومت الکتریکی کاهش می یابد.....	۱۲۴
۴-۳۵ : گاف انرژی با افزایش شار هیدروژن کاهش می یابد.....	۱۲۴
۴-۳۶ : طیف XRD چهار لایه از نمونه CH_3 بازپخت شده.....	۱۲۵
۴-۳۷-۴ : تصاویر FE-SEM از سطح لایه و تصویری از سطح مقطع نمونه CH_3	۱۲۶
۴-۳۸-۴ : لایه CH_3 بازپخت شده در دمای 250°C در دو بزرگنمایی (a) ۱۰۰۰ و (b) ۱۱۰۰۰ برابر.....	۱۲۶
۱-۵ : ساختار بلوری سیلیکون خالص-سیلیکون نوع N و سیلیکون نوع P	۱۳۰
۲-۵ : جایگاه کاتد قبل از قرار دادن مس	۱۳۳
۳-۵ : حمام التراسونیک.....	۱۳۴
۴-۵ : جایگاه زیرلایه و استپ روی آن در حین لایه نشانی.....	۱۳۵
۵-۵ : دستگاه کندوپاش در حین کار با دمای اتاق.....	۱۳۶
۶-۵ : ظرف خالی و محتوى نیتروژن مایع	۱۳۷
۷-۵ : پمپ روتاری	۱۳۹
۸-۵ : پمپ توربیو.....	۱۴۱
۹-۵ : فشارسنجهای روی سیلندر گاز.....	۱۴۰
۱۰-۵ : ظرف اندیکاتور.....	۱۴۰
۱۱-۵ : ترانس و دستگاه اتوواریاک.....	۱۴۱

- ۱۴۲ : دستگاه XRD-STOE دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.....
- ۱۴۳ : XRD نمونه ۱(نهشته بر زیرلایه کوارتز در دمای اتاق) ۱۴۴
- ۱۴۴ : XRD نمونه ۲(نهشته بر زیرلایه کوارتز در دمای 100°C) ۱۴۵
- ۱۴۵ : XRD نمونه ۳(نهشته بر زیرلایه کوارتز در دمای 200°C) ۱۴۶
- ۱۴۶ : XRD نمونه ۴(نهشته بر زیرلایه کوارتز در دمای 300°C) ۱۴۷
- ۱۴۷ : XRD نمونه ۵(نهشته بر زیرلایه کوارتز در دمای 400°C) ۱۴۸
- ۱۴۸ : XRD نمونه ۶(نهشته بر زیرلایه سیلیکون در دمای اتاق) ۱۴۹
- ۱۴۹ : XRD نمونه ۷(نهشته بر زیرلایه سیلیکون در دمای 100°C) ۱۵۰
- ۱۵۰ : XRD نمونه ۸(نهشته بر زیرلایه سیلیکون در دمای 200°C) ۱۵۱
- ۱۵۱ : XRD نمونه ۹(نهشته بر زیرلایه سیلیکون در دمای 300°C) ۱۵۲
- ۱۵۲ : XRD نمونه ۱۰(نهشته بر زیرلایه سیلیکون در دمای 400°C) ۱۵۳
- ۱۵۳ : XRD همه نمونه های نهشته بر زیرلایه کوارتز در یک نمودار ۱۵۴
- ۱۵۴ : XRD همه نمونه های نهشته بر زیرلایه سیلیکون در یک نمودار ۱۵۵
- ۱۵۵ : تصویر AFM از نمونه CD تستر دستگاه ۱۵۶
- ۱۵۶ : تصویر AFM در مذکوره تماسی از نمونه رونشانی شده در دمای 200°C بر کوارتز در بازه ۱۰۱ μm رو بش ۱۵۷
- ۱۵۷ : تصویر AFM در مذکوره تماسی از نمونه رونشانی شده در دمای 200°C بر کوارتز در بازه ۱۰ μm رو بش ۱۵۸

- ۲۸-۵: تصویر دو بعدی و سه بعدی AFM با مد نیمه تماسی از سطح نمونه دمای 400°C بر روی کوارتن و سیلیکون ۱۵۶
- ۲۹-۵: تصاویر AFM مد غیر تماسی نمونه های رونشانی شده برای آنمونه ۱۵۷
- ۳۰-۵: فراوانی ارتفاع نقاط تصاویر AFM مد غیر تماسی نمونه های رونشانی شده ۱۵۸
- ۳۱-۵: یک نمونه از خروجی دستگاه ضخامت سنج Dektak3 دانشگاه تهران برای لایه رونشانی شده در دمای 100°C درجه سانتی گراد و بر زیرلایه کوارتن ۱۶۰
- ۳۲-۵: نمودار تغییرات ضخامت لایه ها نسبت به دما ۱۶۱
- ۳۳-۵: تصویر دستگاه طیف سنج Varian cary-500 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ۱۶۲
- ۳۴-۵: طیف عبوری نمونه های ۱ تا ۵ ۱۶۲
- ۳۵-۵: طیف بازتاب نمونه های ۱ تا ۵ ۱۶۳
- ۳۶-۵: اثر تداخل در بازتاب و عبور نور از یک لایه نازک ۱۶۴
- ۳۷-۵: نمودار ضریب جذب لایه ها ۱۶۵
- ۳۸-۵: نمودار $\alpha h\nu^{1/2}$ بر حسب انرژی و روش بدست آوردن گاف برای نمونه ۱ ۱۶۷
- ۳۹-۵: نمودار $\alpha h\nu^{1/2}$ بر حسب انرژی و روش بدست آوردن گاف برای نمونه ۲ ۱۶۸
- ۴۰-۵: نمودار $\alpha h\nu^{1/2}$ بر حسب انرژی و روش بدست آوردن گاف برای نمونه ۳ ۱۶۸
- ۴۱-۵: نمودار $\alpha h\nu^{1/2}$ بر حسب انرژی و روش بدست آوردن گاف برای نمونه ۴ ۱۶۸
- ۴۲-۵: شماتیک یک Tandem Cell دولایه ای ۱۷۰
- ۴۳-۵: نمودار بازدهی Tandem Cell دولایه ۱۷۰

۱۷۱.....	۴-۵ : بازدهی Tandem Cell با افزایش تعداد لایه ها.....
۱۷۲.....	۴-۵ : نمودار ضریب شکست نمونه های نیترید مس (نمونه های یک تا چهار)
۱۷۳.....	۴-۶ : نمودار ضریب خاموشی نمونه های نیترید مس (نمونه های یک تا چهار)
۱۷۴.....	۴-۷-۵ : نمودار قسمت حقیقیتابع دی الکتریک نمونه های نیترید مس.....
۱۷۵.....	۴-۸-۵ : نمودار قسمت موهمیتابع دی الکتریک نمونه های نیترید مس.....

فهرست جداول:

۵۳.....	۳-۱: اطلاعات حاصل کندوپاش برای فلزات مختلف ($\frac{\text{اتم}}{\text{یون}}$)
۸۴.....	۲-۳ : مشخصات دستگاه DEKTAK3
۸۷.....	۴-۱ : پارامترهای ثابت در لایه نشانی بر زیرلایه های گوناگون
۸۷.....	۴-۲ : پارامترهای شبکه بلوری مواد مورد استفاده در کار تجربی فوق
۹۰.....	۴-۳: پارامترهای شبکه لایه ها (باتوجه به پیشنهادی ۱-۴)
۹۴.....	۴-۴ : نتایج ضخامت و نرخ نهشت نمونه ها.....
۹۷.....	۴-۵ : پارامترهای ثابت آزمایش.....
۹۷.....	۴-۶ : نتایج بدست آمده نمونه ها.....
۱۰۲.....	۴-۷-۷ : نتایج بدست آمده از a_0 ثابت شبکه، C_{ij} ثابت‌های الاستیک، G shear مازول حجم ، E مازول یانگ، E' انرژی تشکیل برای یک سلول واحد و E_{333}' انرژی تشکیل برای یک سلول ۳×۳×۳ برای نیترید مس خالص و بدون دوپینگ و همراه با دوپینگ سایر اتمها.....

۸-۴ : نتایج محاسباتی خواص مغناطیسی ساختار نیترید مس همراه با دوپینگ اتمهای فلزی انتقالی	۱۰۲ H,LI 3d
۹-۴ : نسبت جرمی نیتروژن به کل لایه	۱۱۹	
۱۰-۴ : گاف انرژی ۵ لایه با آهنگهای شارش نیتروژن مختلف	۱۲۰	
۱۱-۴ : ثابت شبکه ، ضخامت لایه و آهنگ لایه نشانی ۵ لایه نهشته با فشارهای جزیی گاز نیتروژن مختلف	۱۲۱	
۱۲-۴ : ضخامت لایه های نیترید مس در حضور گاز هیدروژن	۱۲۲	
۱-۵ : مقایسه حرارتی و سختی کوارتز با شیشه BK7	۱۳۲	
۲-۵ : اطلاعات داده شده توسط XRD برای نیترید مس و بدست آوردن ثابت شبکه و قطر دانه های بلوری	۱۵۲	
۳-۵ : اطلاعات داده شده توسط XRD برای مس و بدست آوردن قطر دانه های بلوری مس	۱۵۳	
۴-۵ : مقادیر roughness شش نمونه گرفته شده در مد غیر تماسی	۱۵۹	
۵-۵ : ضخامت لایه ها	۱۶۰	
۶-۵ : گاف انرژی لایه های نازک نیترید مس نمونه های ۱ تا ۵	۱۶۷	

چکیده:

نیترید مس یک ماده نیمه رسانا با گاف انرژی غیرمستقیم است و با توجه به ترکیب و ساختار بلوری آن مقدار این گاف در محدوده ۰,۸ تا ۱,۹ الکترون ولت (eV) گزارش شده است. ترکیباتی که از نیتروژن و مس ممکن است بوجود آید_۲ (Cu₃N, CuN₄, Cu(N₃) و ... است. که به شرایط لایه نشانی مانند شار و درصد نیتروژن به عنوان گاز واکنشی در دستگاه کندوپاش و نوع دستگاه و فاصله هدف تا زیرلایه وغیره وابسته است. لایه نازک این ماده کاربردهای بسیار خوبی در زمینه الکترونیک، میکروالکترونیک، اپتوالکترونیک دارد. استفاده در ساخت ذخیره کننده های اپتیکی یکبار قابل نوشتن، در تکنولوژی چاپ مدارات الکترونیکی، در مدارهای مجتمع سرعت بالا، در سلولهای خورشیدی، در ساخت مقاومت های تونلی مغناطیسی به عنوان سد در پیوندگاه دو ماده فرومغناطیسی و در باتریهای Li - ion قابل شارژ وغیره از کاربردهای عمدۀ لایه نازک نیترید مس است. در گزارشات مختلف از تهیه Cu₃N در بین سایر ترکیبات بیشتر اسم آورده شده است و احتمال تشكیل این نوع لایه بیشتر از سایر ترکیبات این دو عنصر است. وجود این ماده به صورت طبیعی و در طبیعت تاکنون گزارش نشده است و به همین علت لایه نازک نیترید مس را می بایست توسط دستگاههای لایه نشانی و تحت شرایط خاصی بوجود آورد.

لذا در این کار تجربی و پژوهشی، ما نیز لایه های نازک نیترید مس را روی زیرلایه های سیلیکون و کوارتز در دماهای متفاوت زیرلایه (دماهی اتاق، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ درجه سانتی گراد) توسط سیستم کندوپاش مغناطیسی فعال DC نهشته کردیم و خصوصیات اپتیکی، ساختاری و الکتریکی لایه ها را توسط آنالیزهای XRD و AFM و اسپکتروفوتومتری و مقاومت سنجی انجام دادیم. از تصاویر AFM جهت بررسی مورفولوژی سطح لایه ها و برای سه نمونه (۱۰۰°C و ۲۰۰°C و ۳۰۰°C) انجام دادیم. نشان داده شد که لایه ها به صورت تقریباً یکدست نهشته شده و در دو دمای ۱۰۰°C، ۲۰۰°C، ۳۰۰°C نمونه ها به صورت منظم و دانه ای تشکیل یافته است ولی در دمای دیگر خصوصاً بر زیر لایه سیلیکون، سطح صافتر به نظر می رسد.